

Title (en)

Arrangement of a ceramic heating element as a cooking plate in a recess of a plane surface

Title (de)

Anordnung eines keramischen Heizelementes als Kochzone in einer Aussparung einer Fläche

Title (fr)

Disposition d'un élément céramique de chauffage en tant que zone de cuisson dans un évidement de surface

Publication

EP 0916899 A2 19990519 (DE)

Application

EP 98119600 A 19981016

Priority

DE 19746845 A 19971023

Abstract (en)

[origin: DE19746845C1] The heating element has a ceramics carrier (3) with good heat conduction characteristics fitted into an opening in a cooking hob surface (2) made of ceramics glass, glass, ceramics, metal or plastics, with the surface of the hob having a truncated conical raised edge (2b) around the outside of the opening, on which the peripheral edge of the ceramics carrier is supported. The hob surface is contacted on the underside by a plate attached to the underside of the heating element, or has an integral dished region at the rear of the heating element inserted in the hob opening.

Abstract (de)

Anordnung eines elektrischen Heizelementes (3) als Kochzone mit einer sehr gut wärmeleitenden Keramik als Träger, in einer Aussparung einer Fläche (2) aus Glaskeramik, Glas, Keramik, Metall oder Kunststoff, wobei der keramische Träger des Heizelementes auf Bereichen der Fläche, die von der Hauptebene der plattenförmig ausgebildeten Fläche unter Ausbildung von linienförmig verlaufenden Erhöhungen (2a), wie Kegelstümpfen, Kugelsegmenten und/oder Kegeln abweichen und den Rand der Aussparung definieren, übergreifend aufliegt, wobei diese erhöhte Auflage des Heizelementes (3) als Lager und die Unterseite der Fläche als Widerlager für eine unter der Hauptebene der Fläche angeordnete, die Aussparung nach unten abschließende Abdeckung (5) dient, und mittels mit dem Heizelement (3) fest, und der Abdeckung (5) lösbar fest verbundener Befestigungselemente das Heizelement (3) in der Aussparung der Fläche form- und kraftschlüssig fixiert ist.

IPC 1-7

F24C 15/10; H05B 3/74; H05B 3/68

IPC 8 full level

H05B 3/14 (2006.01); **F24C 7/04** (2006.01); **F24C 15/10** (2006.01); **H05B 3/68** (2006.01); **H05B 3/74** (2006.01)

CPC (source: EP US)

F24C 15/102 (2013.01 - EP US); **H05B 3/74** (2013.01 - EP US)

Cited by

FR2866872A1; US2022252271A1

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

DE 19746845 C1 19981203; BR 9804042 A 19991214; CA 2251242 A1 19990423; DE 59808609 D1 20030710; EP 0916899 A2 19990519; EP 0916899 A3 19990721; EP 0916899 B1 20030604; JP H11218333 A 19990810; PL 329306 A1 19990426; US 6050176 A 20000418

DOCDB simple family (application)

DE 19746845 A 19971023; BR 9804042 A 19981022; CA 2251242 A 19981023; DE 59808609 T 19981016; EP 98119600 A 19981016; JP 29770098 A 19981020; PL 32930698 A 19981021; US 17698198 A 19981022